This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

Also published as:

US4855249 (A1)

METHOD FOR GROWING COMPOUND SEMICONDUCTOR

Patent number: Publication date: JP62119196

1987-05-30

Inventor:

AKASAKI ISAMU; others: 01

Applicant:

UNIV NAGOYA

Classification:

- international:

C30B25/02; C30B29/40

- european:

Application number:

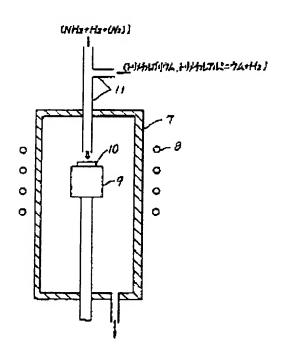
JP19850256806 19851118

Priority number(s):

Abstract of **JP62119196**

PURPOSE:To grow a uniform and good-quality AlxGa1-xN single crystal by heat-treating the surface of a sapphire substrate under specified conditions when AlxGa1-xN is grown on the sapphire substrate by an organometallic compd. vapor growth method.

CONSTITUTION: The (0001) face sapphire single crystal substrate 10 which has been cleaned with org. materials and acids is placed on a graphite susceptor 9 of an organometallic compd. vapor growth device. The substrate 10 is firstly atmosphere-etched at a specified temp. for specified hours while sending H2. The temp. is then lowered to a specified temp., and the substrate 10 is heat- treated for a short time at a temp. lower than the temp. at which an AIN single crystal is grown in an atmosphere wherein at least H2, NH3, and an organometallic compd. contg. Al such as trimethylaluminum are present. Subsequently, an AlxGa1-xN (including x=0) single crystal is further grown at high temp. on the heat-treated substrate 10 by the reaction in an atmosphere contg. H2, NH3, and trimethylgallium.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

19 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公告

⑫特 許 公 報(B2)

 $\Psi 4 - 15200$

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❷❷公告 平成4年(1992)3月17日

C 30 B 29/38 H 01 L 21/205 D Z 7158-4G

発明の数 1 (全7頁)

❸発明の名称 化合物半導体の成長方法

> 顧 昭60-256806 团特

期 昭62-119196 网公

❷出 願 昭60(1985)11月18日 @昭62(1987)5月30日

@発 明 者 赤 勇

号 名大平針宿舎A-112

愛知県名古屋市天白区天白町大字平針字黒石2845番地256

者 個発 明 宜 彦 澤 木

愛知県名古屋市千種区北千種1丁目6番33号 千種西住宅

3棟103号

の出 願 人 名古屋大学長 愛知県名古屋市千種区不老町(番地なし)

弁理士 杉村 暁秀 四分代 理 人

外1名

審査官

酒井 正己

多多考文献 特公 昭59-48794(JP, B2)

1

動特許請求の範囲

1 有機金属化合物とアンモニアガス(NH₃) を水索ガス(H2)またはH2ガスを含む窒素ガス (N₂) 中で反応させてサフアイア基板上に

成長させる方法において、

Alを含む有機金属化合物、NH,及びH,が少な くとも存在する雰囲気中で、2分以下の短時間該 サフアイア基板をAINの単結晶が成長する温度 サフアイア基板上にAINのアモルフアス轉膜を 形成させた後、眩熱処理したサフアイア基板上に Gaを含む有機金属化合物、NH。及びH。が存在す る雰囲気中で、サフアイア基板上のAINアモル ℃の範囲の温度でAl_xGa_{1-x}N単結晶(但し、 0 ≤x≤0.3)を気相成長させることを特徴とする 化合物半導体の成長方法。

2 該サフアイア基板の該熱処理する時間が2分 未満である特許請求の範囲第1項記載の方法。 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明はサフアイア基板上にAlxGai-xNを成 長させる化合物半導体の成長方法に関するもので

あり、特に有機金属化合物気相成長法による化合 物半導体の成長方法の改良に関するものである。 (従来の技術とその問題点)

2

従来の方法では、GaNはGaーHCI-NH:-N2 $Al_xGa_{1-x}N(x=0$ を含む)を少なくとも一層 5 系ハイドライド気相成長法によりサフアイア基板 上にヘテロエピタキシヤル成長させている。 GaNの発光ダイオードは第7図に示すように MIS型の構造をとる。つまり、サフアイア基板1 上にn形GaN 2とDZnを多量にドープした高抵 より低い800℃~1100℃の範囲の温度で熱処理し、 *10* 抗GaN 3 (iーGaN)を成長させ、これに電極 5, 8を形成したものである。この際、i-GaN層 3 は1μm以下で、発光ダイオードの発光 及び動作電圧を決定するため膜厚を精度よくコン トロールする必要がある。しかし、前記ハイドラ フアス膜が完全に単結晶化する以下の950°~1150 15 イド気相成長法により、良質の結晶が得られる条 件としては成長速度が30~60μm/hがよく、こ のため層3を1μm以下で精度よくコントロール することができず、ダイオードの動作電圧のばら つきが大きい。さらに通常良質のGaNを得るに 20 はサフアイア基板上に30μm以上の膜厚に成長す ることが必要であつた。即ち第7図のn-GaN でも30μm以上は必要であつた。しかし、GaNを サフアイア基板上にある程度の膜厚以上成長させ ると第7図に示すように、GaNとサフアイアの 格子定数の差、及び熱膨張係数の差によりクラツ ク12がGaNとサフアイアに入り、ウエハーの 割れ及び特に電極直下のクラツクはリーク電流の 原因にもなり、発光ダイオード製作の歩留りの低 下を招くという問題があつた。

そこで、成長速度を遅くしてi-GaNの膜厚 の精密制御と10μm以下の薄いGaNの成長を目標 として、有機金属化合物、例えばトリメチルガリ ウム (TMG)-NH:-H:系で有機金属化合物気 に示すような成長装置を使用している。即ち、石 英反応管7中に高周波加熱用グラフアイトサセプ ター9上にサフアイア基板10を置き、高周波コ イル8によりサフアイア基板を加熱し、原料導入 付けて基板10上にGaNを成長させている。こ の時手順としてはまずH2を流して基板 10を 1100℃に加熱して清浄化後、基板温度を970℃ま で下げて、TMG及びNHaを流してGaNを成長さ せている。

その結果、成長速度は1~3μm/hと遅くな り、1~4μmの均一な薄膜を成長できるように なつた。これハイドライド気相成長法では得られ なかつた利点である。しかし、薄膜の表面は第8 図に示すように凹凸があり六角錐のグレインもみ 25 られ、反射電子線回析パターン(RHEEDパター ン)をとると単結晶であるが表面に細かい凹凸が あることを示すスポットパターンとなる。一方、 ハイドライド気相成長法のGaNでは、スムース 題があつた。

(問題点を解決するための手段)

本発明者等は、これらの問題点を解決し、均一 で表面が平坦でかつ高品質で、かつ、紫外線又は 長膜の量産可能な成長方法を提供すべく鋭意研究 の結果、有機金属化合物気相成長法によりサフア イア基板上に成長するAlxGa1-xN結晶の品質を 向上させるには、AlxGai-xNとサフアイア格子 て緩和させるかサフアイア表面の改質が必要であ るとの見地に基づき各種の成長または熱処理実験 を重ねた結果、本発明を達成するに至つた。

本発明は有機金属化合物とアンモニアガス

(NH₂) を水素ガス (H₂) またはH₂ガスを含む 窒素ガス (N₂) 中で反応させてサフアイア基至 上にAlxGa:-xN(x = 0 を含む)を少なくとも一 層成長させる方法において、AIを含む有機金属 5 化合物、NH2及びH2が少なくとも存在する雰囲 気中で、2分以下の短時間該サフアイア基板を AINの単結晶が成長する温度より低い800℃~ 1100℃の範囲の温度で熱処理し、サフアイア基板 上にAINのアモルフアス薄膜を形成させた後、 相成長法が研究されている。この方法は、第2図 10 該熱処理したサフアイア基板上にGaを含む有機 金属化合物、NH₂及びH₂が存在する雰囲気中で、 サフアイア基板上のAINアモルフアス膜が完全 に単結晶化する以下の950°~1150℃の範囲の温度 でAl_xGa_{1-x}N単結晶(但し、0≤x≤0.3)を気 管11よりTMG、NH。及びH2を基板10に吹き 15 相成長させることを特徴とする化合物半導体の成 長方法にある。

> 本発明において、単結晶AlxGai-xNのxは0 ≤x≦0.3である。

本発明において、熱処理温度を800℃~1100℃ 20 と限定し、かつGaNの気相成長温度を950℃~ 1150℃と限定したのはAINの単結晶成長温度が 約1200°以上であるので、この温度より低い温度 でないと本発明の所期の目的が達成されないため である。

またサフアイア基板を熱処理する時間は2分未 満とすることが必要である。この理由は2分以上 の長時間加熱すると、AINのパツフア層が適当 値より厚くなり、所期の効果をあげられないため で、AINはアモルフアス膜の状態で基板上に堆 な表面を示すストリークラインパターンとなる問 30 積している状態で、その上にGaNを気相成長さ せるのがよい。

なお、サフアイア基板を熱処理する時間を2分 未満としたのは、2分未満の熱処理でAINのパ ツフア層の厚さが800A以下となるので、AINの 青色の発光特性の良いAl_xGa_{1-x}N単結晶多層成 35 パツフア層の厚さはこれ以上厚いと好ましい結果 を得ないために2分以下と限定したものである。

以下GaN(Al_xGa_{1-x}Nのx=0の場合)の成長 を例にして本発明を説明する。

第2図に示すような成長装置によりGaNをサ 定数のミスマツチを何らかのパツフアー層を介し 40 フアイア基板上に成長するにあたり次の第 1 表(b) に示す成長条件で直接基板上にGaNを成長した もの(以後"通常成長"のものと称す)と第1表 (a)に示す熱処理条件で基板をあらかじめ熱処理し その後その上に第1表(b)に示す成長条件でGaN 5

を成長したもの(以後"熱処理成長"のものと称。 す)の特性を評価した。

第 裹

	,
(a)熱処理条件	温度:900~1000℃
	時間:1分
	トリメチルアルミニウムの 供給量:7×10 ⁻⁶ モル/分
	NH。の供給量:2ℓ/分
	H₂の供給量:3ℓ/分
(b)GaNの成長条件	温度:970~1030℃
*	成長時間:30分
	トリメチルガリウムの供給 量:1.7×10 ⁻⁶ モル/分
	NH:の供給量:1.5ℓ/分
	№の供給量:2.5ℓ/分

まず、結晶性の評価としてX線のロツキングカ ーブを測定した。その結果、第5図に示すように GaNの (0006) の回折で"熱処理成長"のもの のピークの半値幅は2.7分である。一方良質とさ 20 れているハイドライド気相成長法によるGaNの それは10分以上あり、いかなる従来方法よりもは るかに良質の膜が得られることが明らかである。

次に第3図に示すように表面モフオロジーであ るが、"熱処理成長"したGaNの表面は走査電子 25 (実施例) 顕微鏡写真で示されるように非常に平坦で均一な 成長をしており第8図の"通常成長"したGaN の表面に比して格段に優れている。

さらに窒素レーザー励起による77Kでのフオト について比較したところ"熱処理成長"した GaNは"通常成長"したGaNに比べ半値幅が狭 く発光ピークも短波長側にある。このことは"熱 処理成長"したGaN、即ち本発明によるGaNの り純度、あるいは結晶品質がよいことを示してい る。

以上のようにサフアイア基板を第1表(a)の条件 で熱処理を施した後、第1表(b)の条件でGaNを 格段に品質のよいGaN膜が成長する。この理由 については、サフアイア基板にアモルフアス状の AINxが成長しているのではないかと推定される。 第1表(a)の条件で(温度以外の他の条件は同じ

で) 温度を1200℃と高温にして長時間熱処理する とサフアイア上にはAIN単結晶が成長する。し かし、900℃の熱処理ではリード (RHEED) パ ターンからはアモルフアス状態のAIとNの化合

5 物がサフアイア表面についているものと推定され

ところでかかる膜の状態を実験的に十分把持し ていないため、ここでは、熱処理という表現を用 いた。この熱処理の時間があまり長くなると成長 10 層は多結晶となるので、熱処理時間は少なくとも 2分未満である必要があつた。さらに熱処理温度 も、800℃で行なうと、Znをドーピングしても高 抵抗化しない正常な成長していない穴であるピッ トの多い膜となりデバイス化に適さず、また1100 15 ℃で行なうと六角錐の集合体となつて平坦性のよ い膜は得られないので800~1100℃、好ましくは 900~1000℃が適していた。

以上、本発明による"熱処理成長"のものは高 品質のGaNであることが判明した。

GaNの成長を例に説明したが本発明の熱処理 を行なえば $Al_xGa_{1-x}N(x=0$ を含む)の成長に も応用でき、特にxが0≦x≦0.3の範囲では GaNと同様の効果がある。

本発明を次の実施例により説明する。・

実施例 1

第2図に示す有機金属化合物気相成長装置(石 英反応管直径60㎜)のグラフアイトサセプタ9上 に有機洗浄及び酸処理により洗浄した (0001) 面 ルミネツセンス測定を行ないパンド端近傍の発光 30 のサフアイア単結晶基板 1 0 を置き、まずH₂を 0.3 ℓ / 分で流しながら1100℃に上げ10分間基板 を雰囲気エッチングし、次に温度を950℃まで下 げてH₂を3ℓ/分、NH₃を2ℓ/分、トリメチ ルアルミニウム (TMA) を7×10-8モル/分で 方が光学的特性からみても従来方法によるものよ 35 供給して、1分間熱処理する。1分後TMAの供 給を停止してH₂を2.5 ℓ/分、NH₂を1.5 ℓ/分、 トリメチルガリウム (TMG) を1.7×10⁻⁵モル/ 分で供給しながら970℃で30分間GaNを成長す る。この成長により第3図のように平坦な表面を 成長させると"通常成長"したGaNに比して、40 有し、第5図に示すようにX線ロツキングカーブ の半値幅の狭い結晶品質のすぐれたGaNが成長 した。

> なお、Gaの原料としてトリエチルガリウム (TEG) を用いることもできる。この場合、

7

TEGを20℃に保温し、56.5 ml/分のH₂でパブリ ングして供給すれば、同様の結果が得られる。ま たTEGを使えばさらに結晶層の高純度化も期待 できる。

実施例 2

実施例1で述べた条件で洗浄された(0001)面 を持つサフアイア単結晶基板 10を第2図のサセ プタ9上に置き、まずH₂を0.3ℓ/分で流しなが ら1100℃まで上げ、サフアイア基板10を雰囲気 3 ℓ/分、NH.を2 ℓ/分と、TMAを7×10-6 モル/分で供給しながら1分間熱処理する。1分 後TMAの供給を停止して、H2を25ℓ/分、 NHsを1.5 e/分、TMGを1.7×10-5モル/分で ジェチル亜鉛 (DEZ) を約5×10-8モル/分で供 給して5分間成長すると第1図に示すようにサフ アイア基板 1 上に n - GaN 2 と Znドープ i ー GaN 3が形成される。第7図に示したものと異 成し、5を正、6を負として電流を流すと、3と 2層内で5の直下の4の近傍で第4図に示すよう なスペクトルの青色の発光が得られた。

実施例 3

をもつサフアイア単結晶基板 10を第2図のサセ プタ8上に置き、まずH₂を0.3ℓ/分で流しなが ら1100°Cまで温度を上げ、サフアイア基板を雰囲 気ェチッングし、温度を950℃まで下げ、次にH₂ モル/分、TMGを1.7×10-5モル/分で供給しな がら1105℃で15分間AlxGai-xNを成長する。こ の場合x=0.3、即ちAlxGa_{1-x}Nの、構造を持た

ない表面の平坦な膜が得られる。

また0≦x≦0.3の範囲内では同様にして表面 の平坦な膜が得られることが確められた。

(発明の効果)

本発明はサフアイア基板上に、GaAsなどで量 産性が示されている有機金属化合物気相成長法に より、均一で良質のAlxGa1-xN単結晶を成長さ せることができる。

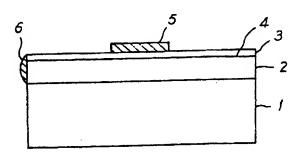
従って、現在高品質化や量産化が遅れている青 エッチングし、温度を950℃まで下げ、次にH₂を 10 色発光ダイオード、レーザーダイオード等の生産 に本発明を利用することができ工業上大なる利益 がある。

図面の簡単な説明

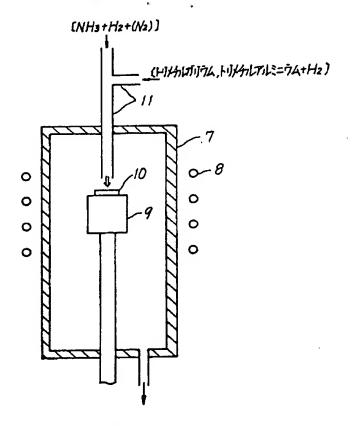
第1図は本発明により製作した青色ダイオード 供給しながら970℃で30分後、TMGに付加して 15 の断面模式図、第2図は本発明において使用する 有機金属化合物気相成長装置の模式図、第3図は 本発明により熱処理成長したGaN表面の操作電 子顕微鏡による結晶の構造写真、第4図は本発明 により製作した一例の発光ダイオードの発光スペ なり、クラツクがない。これに5,6の電極を形 20 クトル線図、第5図は本発明の方法で成長した GaN層と従来方法で成長したGaN層のX線ロツ キングカーブ (0006) の比較図、第6図は本発明 及び従来方法により成長したGaN層のフォトル ミネツセンススペクトル線図、第7図は、従来方 実施例1で述べた条件で洗浄された (0001) 面 25 法により製作したGaN青色発光ダイオードの断 面模式図、第8図は従来方法により製作した GaN層の表面の結晶構造写真である。

1サフアイア基板、2n - GaN、3 ······ i -GaN、5, 6······電極、7······石英反 を3 ℓ/分、NH,を2 ℓ/分、TMAを7×10-6 30 広管、8······高周波コイル、9······グラフアイト サセプター、10……サフアイア基板、11…… 原料導入管、12……クラツク。

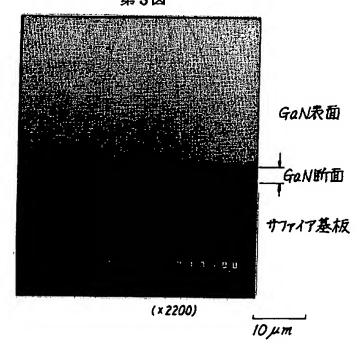
第1図



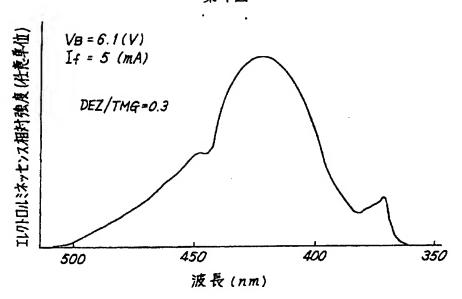
第2図



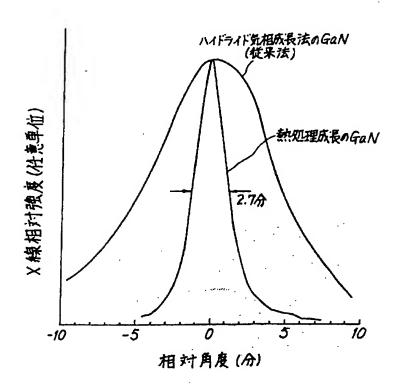
第3図



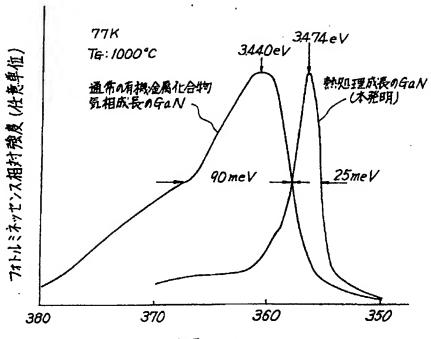
第4図



第5図

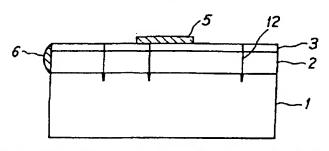


第6図



波長 (nm)

第7図



第8図

